广东世运电路科技股份有限公司

公司代码:603920　　公司简称:世运电路

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	世运电路	603920	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹嘉亮	刘晟
电话	0750-8911768	0750-8911371
办公地址	广东省鹤山市共和镇世运路8号	广东省鹤山市共和镇世运路8号
电子信箱	yinjialiang@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,881,072,466.48	8,988,996,135.42	-1.20
归属于上市公司股东的净资产	6,444,805,740.60	6,471,158,063.35	-0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,578,768,934.58	2,395,654,508.53	7.64
利润总额	431,827,273.01	343,541,280.70	25.70
归属于上市公司股东的净利润	384,134,793.67	302,735,169.28	26.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,547,034.64	298,245,792.66	19.55
经营活动产生的现金流量净额	428,266,324.20	329,614,300.45	29.93
加权平均净资产收益率(%)	5.69	6.89	减少1.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.51	3.92
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.48	10.42

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	104,612
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东顺德控股集团有限公司	国有法人	23.67	170,546,596	0	无	0
新豪国际集团有限公司	境外法人	20.12	144,990,107	0	无	0
广东顺德高新创业投资管理有限公司-广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.01	21,697,368	0	无	0
深圳市沃泽科技开发有限公司	境内非国有法人	1.02	7,316,323	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.55	3,995,519	0	无	0
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50	3,576,892	0	无	0
鹤山市联智投资有限公司	境内非国有法人	0.40	2,866,288	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36	2,584,482	0	无	0
招商银行股份有限公司-国泰研究优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36	2,569,023		无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35	2,501,730		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新豪国际集团有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司、鹤山市联智投资有限公司为关联方。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-062

广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议(以下简称"会议")通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出,于2025年8月26日在公司三楼一号会议室以现场及通讯的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈世运电路2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路2025年半年度报告》及其摘要,《世运电路2025年半年度报告摘要》将同步在公司选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(二)审议并通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案》

根据公司发展战略和实际情况,公司拟将原募投项目"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"尚未投入的部分募集资金52,000.00万元变更投向至新项目"泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目(一期)"。同时,基于原募投项目"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"目前实际建设进度,剩余尚未投入的募集资金合计49,515.35万元将继续用于原募投项目的投资建设。

同时,公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度,"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"将达到预定可使用状态日期由"2025年12月"延长至"2027年6月";"广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目"将达到预定可使用状态日期由"2025年12月"延长至"2026年12月"。新项目达到预定可使用状态日期为2026年12月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的公告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

(三)审议并通过《关于拟投资建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目的议案》

为推进芯片内嵌式PCB产品规模化生产以及提升公司HDI产品的产能,公司计划在鹤山总部周边地块建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目,项目预计总投资约15.00亿元人民币,主要产品为芯片内嵌式PCB产品和高阶HDI电路板产品,设计产能为66万平方米/年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于拟投资建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目的公告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(四)审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司编制了《世运电路2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(五)审议并通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

公司为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,2025年2月28日制定并披露了公司2025年度"提质增效重回报"行动方案。自行动方案发布以来,公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路2025年半年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"的相关内容。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(六)审议并通过《世运电路关于调整使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的议案》

根据公司经营和资金使用安排,在确保满足公司正常经营活动的资金需求及风险可控的前提下,为了提高自有资金的使用效率,公司拟将第五届董事会第三次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》中的投资品种进行调整,同意将投资品种"由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品"调整为"由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行总体风险可控的、流动性较好的投资理财产品,其中风险等级为R3级(中等风险)的理财产品投资额度合计不超过50,000万元"。除上述调整外,其他原审议事项不变,本事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的公告》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(七)审议并通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司的委托理财行为,提高资金运作效率,防范委托理财决策和执行过程中的相关风险,维护股东和公司的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《委托理财管理制度》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(八)审议并通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

(一)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》;

(二)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会战略与ESG委员会第三次会议决议》;

(三)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-063

广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议(以下简称"会议")通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出,于2025年8月26日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席林玉媛主持,会议应参加监事3人,实际参加3人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈世运电路2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路2025年半年度报告》及其摘要,《世运电路2025年半年度报告摘要》将同步在公司选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(二)审议并通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案》

根据公司发展战略和实际情况,公司拟将原募投项目"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"尚未投入的部分募集资金52,000.00万元变更投向至新项目"泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目(一期)"。同时,基于原募投项目"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"目前实际建设进度,剩余尚未投入的募集资金合计49,515.35万元将继续用于原募投项目的投资建设。

同时,公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度,"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"将达到预定可使用状态日期由"2025年12月"延长至"2027年6月";"广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目"将达到预定可使用状态日期由"2025年12月"延长至"2026年12月"。新项目达到预定可使用状态日期为2026年12月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的公告》。

监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目及募集资金投资项目延期事项是公司结合实际情况和自身发展战略,经慎重研究作出的决策,符合公司实际经营需要,不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

(三)审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司编制了《世运电路关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会
2025年8月27日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-065

广东世运电路科技股份有限公司 关于拟投资建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")或控股子公司拟投资建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目(以下简称"芯创智载"项目)

●投资金额:人民币15.00亿元

●审批情况:本次投资事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议批准。本次拟投资项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

●风险提示:本次投资项目是公司基于未来发展战略,经筹划论证所做出的谨慎决定,项目投产运营后可能面临受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响,可能造成投资项目不达预期效益的风险。本次投资项目的投资金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。项目预计在2025 年下半年动工建设,2026年中开始投产,对公司2025年经营业绩不会造成重大影响。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

随着近年人工智能及新能源汽车技术的高速发展,PCB作为电子产业的一种核心基础组件,对PCB供应商的生产工艺以及供应链联合创新能力提出了更高的要求,包括具有高密度及多层设计、高性能材料、精细制造工艺、优质的信号传输及散热等特性。公司于2022年获广东省发展和改革委员会批准成立"新一代电动汽车高端芯片互连载板创新平台",依托该平台着力发展"芯片内嵌式PCB封装技术",即采用嵌埋工艺将功率芯片直接嵌入到PCB板内,通过创新的制程工艺实现器件与PCB的一体化,优化芯片与电路板的信号传输路径与散热性能,提高系统功效和可靠性,在新能源汽车、数据中心、高功率通信设备、人形机器人、储能、航空航天等领域具有广阔的应用前景。目前该项目已经取得显著成果,芯片内嵌式PCB产品已经通过一系列静态、动态测试达成性能设计和信赖性要求,并陆续获得终端主机厂客户项目定点。

为推进芯片内嵌式PCB产品规模化生产以及进一步提升公司高阶HDI产品的产能,公司计划在鹤山总部周边地块建设"芯创智载"项目,项目预计总投资约15.00亿元人民币,主要产品为芯片内嵌式PCB产品和高阶HDI电路板产品,设计产能为66万平方米/年。

(二)审议情况

公司第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于拟投资建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。本次拟投资项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资项目基本情况

(一)项目名称:"芯创智载"新一代PCB智造基地项目

(二)项目实施主体:公司或控股子公司

(三)项目实施地点:鹤山市共和镇铁岗工业区

(四)项目投资概算:项目总投资额为人民币15.00亿元,具体将根据实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准

(五)项目建设内容:本项目总投资额为15.00亿元,其中建筑工程费4.63亿元,设备购置及安装费9.62亿元,铺底流动资金0.6亿元。项目通过引进国内外先进的印制电路板生产设备及配套设施,招聘高素质的技术、管理和生产人员,旨在提升公司高端电路板的量产能力,满足下游客户对PCB不断提升的工艺要求,以及增强公司的核心竞争力。

(六)项目产品类型及产能:芯片内嵌式PCB产品18万平方米/年,高阶HDI电路板产品48万平方米/年。

(七)项目建设周期:18个月,计划于2025 年下半年动工建设,2026年中开始投产。

(八)资金来源:自有或自筹资金

(九)项目进展及审批、备案情况:项目尚处于筹备阶段,尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

三、本次投资的背景、必要性及可行性

(一)本次投资的背景和必要性

根据Prismark预计,2025年HDI和18层以上多层板将分别增长12.9%和41.7%,从中长期来看,18层以上高多层板和HDI受到人工智能相关产业的驱动,2024年-2029年复合增长率将分别达15.7%和6.4%,高于PCB行业整体约5.2%平均增速。其中,芯片内嵌式PCB产品是PCB未来的发展方向之一。芯片内嵌带来三大核心优势:(1)消除键合线,减小机械应力失效,显著提升芯片互连技术的可靠性;(2)通过消除键合线并采用超短连接路径,电感可降至1nH以下,进一步会降低开关损耗和电压过冲,大幅改善电气性能;(3)通过内嵌的方式,不仅减少了封装体占用的空间、降低了封装成本,还一定程度提升了电气性能和散热效果。通过功率芯片PCB封装化实现模组高能耗比、高密度轻量化和高可靠性

人工智能、新能源汽车等重点下游领域增速较快,带动高端PCB需求和价值增长。首先,从市场需求角度,公司HDI业务近两年需求增长强劲,特别是人工智能、汽车电子、医疗电子等领域订单显著增加,而当前公司现有的HDI产能不足,制约了公司在这些高增长领域的业务拓展。其次,从公司战略布局来看,推进芯片内嵌式PCB产品规模化生产以及进一步提升公司高阶HDI产品的产能有助于公司优化产品结构,提升在高端 PCB 领域的竞争力,符合公司向高附加值产品领域转型的长期战略目标。通过扩大高端产品产能,公司能够进一步提升规模效应,降低单位生产成本,提高产品的市场竞争力,增强公司的盈利能力与抗风险能力。综上,公司计划因应市场需求变化,放缓公司定增募投项目的建设进度,将资源优先集中推动建设"芯创智载"项目。

(二)本次投资的可行性

凭借多年在PCB研发、生产经验,公司拥有PCB制造领域多项核心技术,并高效地转化为产品竞争力的提升。公司目前已经掌握本项目的核心技术"芯片内嵌式PCB封装技术",相关产品已经通过一系列静态、动态测试达成性能设计和信赖性要求,并获得部分主流汽车终端主机厂和OEM的认可。

此外,经过多年发展,公司凭借先进的技术、高质量的产品和专业的服务,已与国内外众多知名品牌商建立了长期稳定的合作关系,积累大量优质稳定的客户资源,广泛分布于人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域。

四、本次投资对上市公司的影响

公司拟投资建设"芯创智载"项目,旨在提升公司高端电路板的量产能力,满足下游客户对PCB不断提升的工艺要求,以及增强公司的核心竞争力。芯片内嵌式PCB产品目前主要应用在新能源汽车动力域,通过更高的集成度和功率密度,显著提升了电气性能,包括降低系统杂感及开关损耗,大幅提升开关速度,从而达到提升续航里程的效果。目前芯片内嵌式PCB产品已获得部分主流汽车终端主机厂和OEM的认可,产品需求市场日益扩大。本项目具备良好的预期经济效益,建成后将为公司增加新的利润增长点,提升企业品牌影响力,与公司的长远规划和高质量发展战略要求相契合。该项目的建设不会损害上市公司及股东的利益,特别是中小股东的利益。

本次对外投资的资金全部来源于公司或控股子公司自有或自筹资金,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。同时,本次拟新设的控股子公司将纳入公司合并报表,不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

五、对外投资的风险分析

(一)市场竞争风险

随着国内PCB同业在新能源汽车、数据中心/服务器、通信设备PCB等领域的布局,后续市场竞争可能存在愈发激烈的风险,进而影响行业整体的盈利能力。虽然目前行业领先企业具有较为明显的综合竞争优势,在客户、规模、研发、技术、质量、成本控制等多个方面均处于优势地位。但由于国内从事PCB生产的企业较多,且部分企业成长较快,竞争力日益增强。随着市场的扩大,竞争对手也将加大对产品研究开发和市场开拓力度,导致竞争加剧,项目可能面临客户及订单数量不及预期的风险。公司将加大研发投入,提升技术能力,开发高附加值的新产品,调整产品结构,提升高端产品占比,积极开拓新的订单稳定的客户,以此提高公司抗风险能力。

(二)项目建设、产能爬坡不达预期风险

本项目在实施过程中,可能存在工程建设进度不及预期、设备采购及安装调试延期、设备价格和原材料价格波动等问题,导致项目建设周期延长、实际投资额超出预算,实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异。公司将成立项目管理团队,制定详细的项目实施计划和应急预案,加强与供应商及承建商等合作伙伴的沟通协调,严格控制项目进度和成本管理,确保项目按计划推进。

(三)项目管理运营风险

高端PCB产品技术含量高,若公司在技术研发、工艺创新方面未能持续投入或未能准确把握行业技术发展趋势,可能导致新增产能的技术水平未能跟上市场需求变化,产品竞争力下降。新产品在量产过程中可能面临良率不稳定、产能利用率不高等问题,影响项目盈利能力。公司将继续强化研发优势,保证产品符合客户需求、适应行业发展趋势,并将通过科学的管理手段继续提高产品质量的稳定性,以良好的质量推动市场份额的提升。

(四)项目投资资金风险

本项目总投资约15亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金,若未来公司经营活动现金流不及预期或外部融资环境发生不利变化,可能面临一定的资金筹措压力。截至2025年6月30日,公司营业收入25.79亿元,货币资金14.93亿元,交易性金融资产28.26亿元,总资产88.81亿元,资产负债率25.20%。公司资信情况良好,银行授信额度充足,没有对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求,与供应商充分协商更友好的付款方式,根据需要科学规划融资方案,优化资本结构,合理控制融资成本和财务风险,确保足够的资金投入以满足项目建设需求。

(五)项目审批风险

本项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,存在无法取得或无法按时取得相关许可和影响投资计划顺利实施的风险。公司会按照当地相关部门要求,积极推进项目投资建设实施工作。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-066

广东世运电路科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1017号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")采用代销方式,向特定对象发行人民币普通股股票117,964,243股,发行价为每股人民币15.20元,共计募集资金179,305.65万元,坐扣承销及保荐费1,393.06万元(该部分为不含税金额,属于发行费用),持续督导费400.00万元(该部分不属于发行费用)后的募集资金为177,512.59万元,已由主承销商中信证券于2024年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用212.36万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为177,700.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕3-8号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	177,700.23
截至期初累计发生额	项目投入	B1	49,472.84
	利息收入净额	B2	1,280.35
本期发生额	项目投入	C1	5,467.58
	利息收入净额	C2	1135.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	54,940.41
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,415.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2	125,175.47
实际结余募集资金		F	125,249.04
差异		G=E-F	-73.57

注1:公司应结余募集资金比实际结余募集资金少73.57万元。其中,自有资金账户支付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用81.90万元;募集资金专户销户,产生的利息和理财收益8.17万元;转账产生的手续费0.16万元所致。

注2:以上数据如有尾差为四舍五入所致。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐人中信证券于2024年4月分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中信银行股份有限公司江门分行、中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。其中开设在中国建设银行股份有限公司江门市分行的银行账户已于2024年6月注销,所签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,本公司有4个募集资金专户、4个募集资金理财专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号/证券账号	募集资金余额	备　注
中国农业银行股份有限公司鹤山共和科技支行	44411501040010258	616.06	
中国银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行	740678234630	116,991,365.60	
中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006229200081444	2,759,863.03	
中信银行股份有限公司江门分行	8110901012101686782	132,738,599.90	
中国银河证券股份有限公司江门发展大道证券营业部	333300030368	100,000,000.00	
广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部	192900061808	700,000,000.00	
广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部	192900061810	0	
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部	35000000283	200,000,000.00	
合　计		1,252,490,444.59	

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司向特定对象发行A股股票募集资金在本报告期的使用情况,参见"向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表"(见附件)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,于2024年4月24日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2024〕3-221号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐人中信证券发表核查意见。

公司于2024年7月24日置换4,722.96万元,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币4,722.96万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

公司于2024年4月1日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

报告期内,公司使用募集资金进行现金管理明细如下:

金额单位:人民币万元

受托人	产品名称	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	截至报告期末未到期金额	本金回收情况
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4586期	券商理财产品	10,000,000.00	2024/5/13	2025/2/6	保本浮动收益	0.00	全部收回
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4587期	券商理财产品	20,000,000.00	2024/5/13	2025/2/6	保本浮动收益	0.00	全部收回
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4588期	券商理财产品	20,000,000.00	2024/5/13	2025/2/6	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBRI)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBNI)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBQI)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBMI)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBOI)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBPI)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBSI)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4804期-数字看涨(银河中国多策略指数)	券商理财产品	50,000,000.00	2024/10/29	2025/2/6	保本浮动收益	0.00	全部收回
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4805期-保守看涨(银河商品动量指数)	券商理财产品	50,000,000.00	2024/10/29	2025/3/27	保本浮动收益	0.00	全部收回
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4843期-保守看涨(银河商品动量指数)	券商理财产品	50,000,000.00	2024/11/15	2025/3/17	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UCAI)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/11/22	2025/2/20	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UCBI)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/11/22	2025/2/20	保本浮动收益	0.00	全部收回
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20111期	券商理财产品	100,000,000.00	2025/2/1	2025/5/6	保本浮动收益	0.00	全部收回
中国银行	人民币结构性存款【CSD-VY202503242】	券商理财产品	100,000,000.00	2025/2/24	2025/5/12	保本浮动收益	0.00	全部收回
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21058 期	券商理财产品	200,000,000.00	2025/2/22	2025/5/23	保本浮动收益	0.00	全部收回
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 08894 期	券商理财产品	100,000,000.00	2025/2/22	2025/5/23	保本固定收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UFEI)	券商理财产品	100,000,000.00	2025/2/26	2025/8/27	保本浮动收益	100,000,000.00	/
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UFFI)	券商理财产品	200,000,000.00	2025/2/26	2025/8/27	保本浮动收益	200,000,000.00	/
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"1号(GI-SYDT)	券商理财产品	300,000,000.00	2025/2/26	2025/8/27	保本浮动收益	300,000,000.00	/
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A04856期	券商理财产品	100,000,000.00	2025/5/22	2025/8/20	保本浮动收益	100,000,000.00	/
银河证券	"银河金鼎"收益凭证5049期-保守看涨(银河中国多策略指数)	券商理财产品	100,000,000.00	2025/5/23	2026/2/26	保本浮动收益	100,000,000.00	/
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UGZI)	券商理财产品	100,000,000.00	2025/5/30	2025/11/26	保本浮动收益	100,000,000.00	/
中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列【455】期收益凭证(SRHJ55)	券商理财产品	100,000,000.00	2025/5/29	2026/3/24	保本浮动收益	100,000,000.00	/
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1903】期收益凭证【SRSG51】	券商理财产品	100,000,000.00	2025/6/11	2026/3/9	保本浮动收益	100,000,000.00	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并按要求对募集资金使用情况进行了披露,本报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件

向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
2025年1-6月

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	177,700.23	本年度投入募集资金总额	5,467.58
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	54,940.41
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)	否	109,700.23	109,700.23	109,700.23	3,886.96	8,184.88	−101,515.35	7.46	2025年12月	不适用	不适用	否
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,580.62	8,755.54	−21,244.46	29.19	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	177,700.23	177,700.23	177,700.23	5,467.58	54,940.41	−122,759.81	30.92	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年4月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。公司已于2024年7月24日完成置换,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币4,722.96万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币110,000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-068

广东世运电路科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东会召开日期:2025年9月11日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月11日 13点30分

召开地点:广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月11日

至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2025年8月26日召开的公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,相关公告已于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603920	世运电路	2025/9/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

(二)参会登记时间:2025年9月8日上午9:00-11:30下午:13:30-16:30

(三)登记地点:公司董事会办公室

(四)股东可采用电子邮件的方式进行登记(需提供有关证件复印件),以登记时间内公司收到为准,并请注明联系电话。公司联系邮箱为:olympic@olympicpcb.com

六、其他事项

1、本次股东会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:刘晟

电话:0750-8911371

传真:0750-8919888

电子邮箱:jason.liu@olympicpcb.com

3、联系地址:广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

邮编:529728

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

1、委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-069

广东世运电路科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月3日(星期三)上午10:00-11:00

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可以在2025年8月28日(星期四)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或者通过公司邮箱(olympic@olympicpcb.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果及财务状况,公司计划于2025年9月3日(星期三)上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动方式召开,公司将针对2025年半年度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月3日(星期三)上午10:00-11:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:董事长林育成先生,副董事长兼总经理余英杰先生,董事兼财务总监蒋毅先生,董事会秘书尹嘉亮先生,独立董事陈景山先生(参与人员可能会根据实际情况调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可以在2025年9月3日(星期三)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月28日(星期四)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或者通过公司邮箱(olympic@olympicpcb.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门:公司证券事务部

电话:0750-8911371

邮箱:jason.liu@olympicpcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-064

广东世运电路科技股份有限公司 关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●原项目一名称:鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)(以下简称"原项目一")

●原项目二名称:广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目(以下简称"原项目二")

●新项目名称、投资金额:泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目(一期)(以下简称"新项目"),计划总投资额为112,649.78万元。

●变更募集资金投向的金额:原项目一的募集资金承诺投资总额为109,700.23万元,本次拟将其中52,000.00万元变更投向至新项目。同时,基于原项目一的实际建设进度,剩余尚未投入的募集资金合计49,515.35万元(截至2025年6月30日已投入8,184.88万元,不包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益等扣除银行手续费后的净额,实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准)将继续用于原项目一的投资建设。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目正在实施中,目前已完成主体建筑工程施工,正在进行机电工程安装,设备的购买、安装及调试工作,该项目计划建设周期为24个月,预定达到可使用状态日期为2026年12月。

●募投项目延期的情况:原项目一、原项目二原预定达到可使用状态日期为2025年12月,现项目一计划延长至2027年6月,项目二计划延长至2026年12月。

●本次变更部分募投项目及部分募投项目延期不构成关联交易,尚需提交股东会审议。

一、变更募集资金投资项目、募集资金投资项目延期的概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1017号),公司向特定对象发行人民币普通股股票117,964,243股,发行价为每股人民币15.20元,共计募集资金179,305.65万元,坐扣承销及保荐费1,393.06万元(该部分为不含税金额,属于发行费用),持续督导费400.00万元(该部分不属于发行费用)后的募集资金为177,512.59万元,已由主承销商中信证券于2024年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用212.36万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为177,700.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕3-8号)。

(二)募集资金实际使用情况

截至2025年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	累计已投入募集资金总额	募集资金余额	募集资金投入进度
1	鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)	116,899.81	109,700.23	8,184.88	101,515.35	7.46%
2	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,000.00	8,755.54	21,244.46	29.19%
3	补充流动资金	38,000.00	38,000.00	38,000.00	-	100.00%
合计		184,975.51	177,700.23	54,940.42	122,759.81	-

注1:"募集资金承诺投资总额"为公司根据扣除发行费用后的实际募集资金净额调整后的拟使用募集资金投资金额。

注2:"募集资金余额"为截至2025年6月30日数据,不包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益等扣除银行手续费后的净额,实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准。

注3:以上数据如有尾差为四舍五入所致。

(三)拟变更募集资金投资项目、募集资金投资项目延期的情况

1、原项目一拟变更及延期情况

根据公司发展战略和实际情况,公司拟将原项目一"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"尚未投入的部分募集资金52,000.00万元变更投向至新项目"泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目(一期)"同时,基于原项目一目前实际建设进度,剩余尚未投入的募集资金合计49,515.35万元将继续用于原项目一的投资建设。

同时,公司结合原项目一的实际建设情况和投资进度,将原项目一达到预定可使用状态日期由"2025年12月"延长至"2027年6月"。新项目达到预定可使用状态日期为2026年12月。

2、原项目二延期情况

公司结合原项目二的实际建设情况和投资进度,将原项目二达到预定可使用状态日期由"2025年12月"延长至"2026年12月"。

上述原项目一、二调整前后的具体情况如下表列示

单位:万元

调整前			
项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期
鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)	116,899.81	109,700.23	2025年12月
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,000.00	2025年12月
调整后			
项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期
鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)	62,895.03	57,700.23	2027年6月
泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目(一期)	112,649.78	52,000.00	2026年12月
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,000.00	2026年12月

新项目拟投入募集资金总额为52,000.00万元,占公司实际募集资金净额的29.26%。本次变更募集资金投资项目及部分募投项目延期事项不构成关联交易。

二、变更部分募集资金投资项目、募集资金投资项目延期的具体原因

(一)原项目一计划投资和实际投资情况

原项目一"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"实施主体为广东世运电路科技股份有限公司,实施地点位于广东省江门市鹤山市共和镇世运路8号,项目总投资额为116,899.81万元,其中建筑工程费550.00万元,设备购置及安装费110,679.95万元,铺底流动资金5,669.86万元,建设周期24个月。项目达产后预计将实现年销售收入160,560.00万元(不含税),年均税后净利润20,086.12万元。截至2025年6月30日,累计已投入募集资金8,184.88万元,投入进度为7.46%,尚未投入的募集资金余额为101,515.35万元。为保障募投项目整体经济效益,公司根据战略布局调整及市场环境变化,已适度放缓原项目一投资进度。

(二)原项目一变更后的情况

1、项目名称:鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)

2、实施主体:广东世运电路科技股份有限公司

3、建设地点:鹤山市共和镇世运路8号

4、项目建设周期:本项目建设周期为42个月

5、项目建设内容:本项目总投资额为62,895.03万元,拟使用募集资金投资金额为57,700.23万元,具体的项目构成为:其中建筑工程费550.00万元,设备购置及安装费58,870.81万元,铺底流动资金3,474.22万元。项目通过引进国内外先进的印制电路板生产设备及配套设施,招聘高素质的技术、管理和生产人员,扩大公司PCB生产规模,提高生产效率,优化产品结构,从而进一步提升公司收入水平、增强盈利能力。项目建成后,公司将新增年产双面板、多层板及HDI板70万平方米的产能。

6、经济效益分析:经预测分析,项目达产年将实现销售收入97,515.00万元,净利润12,085.43万元。本项目财务内部收益率与投资回收期均处于正常水平,各项经济效益指标合理,均符合国家有关规定及投资方要求,在经济效益方面是切实可行的。

(三)原项目一变更具体原因

本次考虑变更部分原项目一募集资金投向新项目,主要基于公司战略布局调整及市场环境变化等因素,具体原因如下:

1、推进全球化战略

首先从产能布局来看,公司现有产能集中于国内,为更好地满足国际市场需求、深化全球化布局,提高客户的供应链安全系数,建设海外生产基地成为必要举措。其次从客户服务来看,新项目不仅能实现对国际客户的快速响应、提升海外客户服务质量,更有助于公司向"国内领先、国际一流的PCB行业领军企业"目标迈进。再次从技术资源来看,在海外建设生产基地有利于吸引海外高端PCB人才,提升公司PCB研发、生产技术。因此,目前对公司来说,建设海外生产基地的优先级较高。

2、产品升级转型需要

近年人工智能的发展推动了一系列上下游企业的技术升级,其中所需的PCB具有高密度及多层设计、高性能材料、精细制造工艺、优质的信号传输及散热等特性,这对PCB供应商的生产工艺以及供应链提出了更高的要求。加上国内市场竞争激烈,尤其是中低端市场,长期处于内卷状态。因此,为了适应市场发展需求,提升公司的核心竞争力,公司计划调整原项目一的产能规划,年产能由150万平方米下调至70万平方米,高多层、HDI电路板占比增加。

(四)原项目一、原项目二延期的具体原因及延期后保障措施

1、原项目一、原项目二延期的具体原因

为进一步优化资源配置、深化全球化战略布局,更好地满足国际市场需求,集中资源加速海外生产基地建设,经审慎研究后决定对原项目一、原项目二进行延期。

2、延期后保障项目按期完成的相关措施

(下转B252版)